



2025年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
代 表 者 代表執行役社長 横山 毅
(コード番号：6627 東証スタンダード)
問 合 せ 先 財 務 部 長 帯 田 大 悟
(TEL 045-476-5711)

立地協定調印に関するお知らせ

当社は、本日、九州事業所（熊本県葦北郡芦北町）における設備増設について、熊本県の立会いの下、芦北町との立地協定に調印いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 立地協定調印の目的

当社は、国内における半導体生産能力の拡大に伴い、テスト需要が増加していることを受け、現在も慎重に状況を見極めながら、半導体設備の増設や従業員の増員を継続的に実施するなど、業績拡大を目指した計画を進めております。

今般、当該計画の一部について、主に以下の内容の半導体設備の増設、並びに地域開発の協力及び地域の雇用創出等を目的として、芦北町と立地協定を締結し、熊本県企業立地促進補助金制度（注1）の適用を受けることとなりました。

- (1) 設備増設額： 50億円（注2）
- (2) 着工時期： 2025年2月
- (3) 計画完了時期： 2028年1月（予定）

注1： 熊本県企業立地促進補助金

<https://www.kumamoto-investment.jp/kiji003145/index.html>

本件は、「1. 重点5分野」の対象。

注2： 上記計画期間中における設備投資の規模が、上記金額等に限定されるものではありません。

2. 業績への影響

半導体設備増設等に伴う当社グループの業績に与える影響は、業績予想発表時に、都度、織り込んで開示いたします。また、熊本県企業立地促進補助金制度により、当社の設備増設等の実績が支給要件を充足した場合に交付される可能性がある補助金につきましても、今後、別途開示が必要となった際は、速やかに開示いたします。

以 上